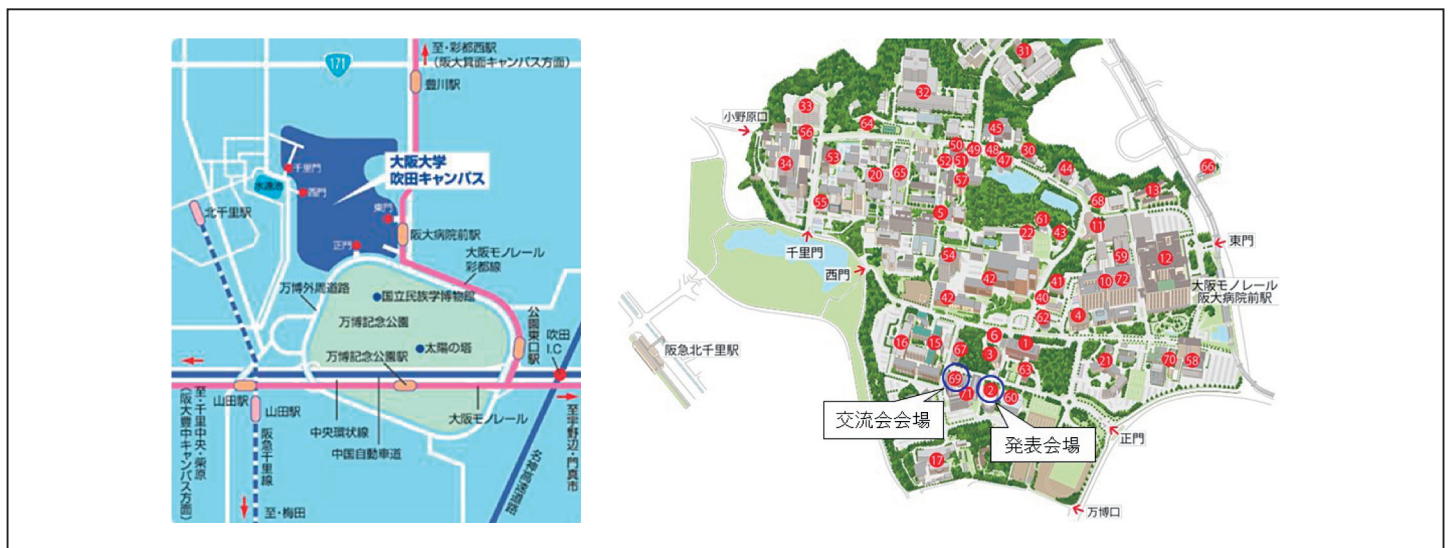


MES 2018 プログラム			9月6日(木)	
	B会場	C会場	D会場	E会場
9:50	[1B1] めっき技術 -1<めっきの機能> <ol style="list-style-type: none"> 例鎖結晶性ブロック共重合体の無電解めっき前処理への利用 ○中野涼子, 内野智仁, 関口博史, 八尾滋(福岡大学) UV改質法による絶縁材料への導電膜形成および選択めっき法への応用 ○井上浩徳¹, 高山昌敏², 渡邊充広³(¹江東電気, ²関東学院大学, ³上村工業) 無電解Co-W-Pめっき皮膜のバリア性の評価 ○神崎翔, 柴田利明, 黒坂成吾, 小田幸典, 橋本滋雄(上村工業) 無電解パラジウムめっき膜中の水素 ○相良優作¹, 小田幸典², 福室直樹³, 八重真治⁴(¹兵庫県立大学, ²上村工業) 電磁波吸収用金属-絶縁物複合膜のウェットプロセス形成 ○竹内誠¹, 武藤浩行², 藤田直幸³(¹奈良工業高等専門学校, ²豊橋技術科学大学) 	[1C1] Fan-outパッケージ/MID/3D/TSV技術 <ol style="list-style-type: none"> 構造解析を活用したFO-PLPの反り量低減検討 ○瀬川幸太, 鈴木直也, 濱口宏治(日立化成) 金属複合MIDによる立体回路モジュールの高放熱化 ○三宅貴大, 川北嘉洋(パナソニック) ノッチレスSiエッチングと第1金属層のウェット洗浄で形成した微細TSVつき薄形チップの積層 ○渡辺直也¹, 菊地秀和², 柳澤あづさ³, 島本晴夫⁴, 菊地克弥⁵, 青柳昌宏⁶, 中村彰男⁷, 矢部幸治⁸(¹産業技術総合研究所, ²ラピスセミコンダクタ) 貴金属触媒を用いた湿式Si-TSVエッチングにおける添加剤の効果 ○丹羽良輔, 花谷俊輔, 山口嵩人, 清水智弘, 伊藤健, 新宮原正三(関西大学) 微細コーン型金バンプの形状・機械的特性に及ぼすナノ粒子生成条件の影響 ○橋野健, 林瑛瑛, 仲川博, 青柳昌宏, 菊地克弥(産業技術総合研究所) 高番手Si/Cu同時研削と残留金属低減処理を用いたSi貫通電極露出工程 ○渡辺直也¹, 山本寛², 三井貴彦³, 山本栄一⁴(¹産業技術総合研究所, ²岡本工作機械製作所) 	[1D1] ものづくりセッション <ol style="list-style-type: none"> 低環境負荷対応ドライフィルムレジスト剥離プロセス ○文蔵隆志, 谷本樹一, 新城沙耶加(ICU) 新規銀ナノ粒子ペーストによるアルミニウムを中心とした接合技術の開発 ○長澤浩¹, 中島啓光², 雨宮隆³, 伊藤公紀⁴(¹環境レジリエンス, ²横浜国立大学, ³電気通信大学) 基板分割装置と基板試作装置 ○藤村迅(イブプロノクス) 回路図設計段階でJTAGテストの容易化設計を支援するプラグインツール ○浅野義雄(富士設備工業) 機電一体・FO-WLP・MIDなど次世代向け設計ツールの紹介 ○長谷川清久¹, 松澤浩彦², 福岡輝³(¹図研, ²図研テック) 電子部品向け印刷用メタルマスク技術 ○加藤晶規(アテネ) 	[1E1] 先端材料 -1<粒子・ペースト> <ol style="list-style-type: none"> エポキシ系バインダ中で誘導される銀ナノ粒子の低温焼結挙動 ○中澤史穂, 井上雅博(群馬大学) 低温焼結能を有するサブミクロン銀粒子の開発と実装用途への応用 ○森崇充, 三並淳一郎, 奥田真利, 岩佐成人, 福井太郎(大阪ソーテック) 焼結型銀ペーストを用いた銅への無加圧接合に関する研究 ○増山弘太郎, 野中荘平, 八十嶋司, 片瀬琢磨, 石川雅之(三菱マテリアル) 高純度Cuデンドライト結晶を利用したCuマイクロ粒子の生成と伝導性塗料の開発 ○田邊ほの香, 黒田純也, 宇田里紗, 山中公博, 田口博久(中京大学) 脂肪族アミン処理をしたフェノール系銅ペーストの高温曝露中における電気伝導特性変化 ○瓦井健太¹, 井上雅博², 宇田里紗³(¹群馬大学, ²大阪大学)
11:50				
12:40	[1B2] めっき技術 -2<最終表面処理> <ol style="list-style-type: none"> 無電解Ni/Pd/Auめっきにおけるはんだボール接続信頼性-金属間化合物の成長に及ぼす電解Pdめっき膜厚の影響 ○江尻芳則¹, 櫻井健久², 荒山貴慎³, 坪松良明⁴, 長谷川清⁵(¹日立化成, ²日立化成テクノサービス) 微細Cu配線向け無電解超薄膜Niめっき皮膜形成の検討 ○加藤友人, 寺島肇, 八木薫, 渡邊秀人(小島化学薬品) 無電解超薄膜Ni/Pd/Auめっきプロセスの開発 ○加藤友人, 寺島肇, 八木薫, 渡邊秀人(小島化学薬品) 新規表面酸化防止処理技術を用いたPWB用無電解Ni/Pd/Auめっきプロセス ○大内高志, 渋谷宏明, 珍田聡(JX金属商事) 銅配線上のダイレクト無電解Pd/Auめっきプロセスの検討 ○安藤直行, 渋谷宏明, 珍田聡(JX金属商事) 	[1C2] はんだ技術 <ol style="list-style-type: none"> マイクロ波を用いたはんだ溶融による電子部品実装技術の開発 ○金澤賢司, 渡邊雄一, 西岡輝輝, 中村考志, 植村型(産業技術総合研究所) 鉛フリーはんだの接合信頼性に及ぼすBiおよびSb添加の影響 ○石川俊輔, 池田一輝, 中西研介(ハリマ化成) パワー半導体モジュールのパワーサイクル試験におけるダイアタッチ材のクリープ変形解析 ○細谷康佑, 菊谷義治(芝浦工業大学) はんだ接合部金属間化合物の電圧変化メカニズム ○松岡寿和¹, 尾上涼輔², 酒井翼³, 瀬井翼⁴, 野口真男⁵, 山中公博⁶(¹中京大学, ²中京大学, ³トヨタ自動車) 表面実装におけるソルダペーストの溶融挙動分析及びボイド低減の実現 ○李建永, 高橋政典, 長谷川将司, 佐藤藤祐, 新子比呂志(クオルテック) 	[1D2] パワーエレクトロニクス -1<システム> <ol style="list-style-type: none"> パワーモジュールのパッケージング技術 ○新井規由(三菱電機) (依頼講演40分) 高耐圧SiCパワー半導体モジュールの開発 ○池田良成, 谷口克己, 金井直之, 保谷昌志, 高柳良平, 堀元人, 熊田恵志郎, 丸山宏二(富士電機) 両面冷却パワーデバイスの過渡熱測定とシミュレーションのモデル同定 ○原智章¹, 青木慎孝², 舟木剛³(¹メンター・グラフィック・ジャパン, ²大阪大学) パルスパワー技術を用いた大電力宇宙プラズマロケットの実験室実験 ○上野一磨, 大塚俊輔, 坂田唯, 大東京太郎(中京大学) 	[1E2] 先端材料 -2<機能・デバイス> <ol style="list-style-type: none"> マテリアルズ・インフォマティクスを活用した高密度材料の設計技術 ○岩崎富生(研究開発グループ) 高熱伝導カーボンナノチューブ放熱シートの実現 ○廣瀬真一, 鈴木幸一, 近藤大雄, 岩井大介, 佐藤信太郎(富士通研究所) 電析法によるCu/ZnSの作製とバンド構造の推定 ○松田直大, 岡本尚樹, 齊藤丈靖(大阪府立大学) リフロー耐性を有するスクレーラブル空気亜鉛一次電池の試作・評価 ○渡邊敏仁, 松本圭司, 森裕幸(日本アイ・ピー・エム) 角度可変架台による積雪時の太陽光発電効率向上 ○橋田太樹(クミックス)
14:20	ものづくりコアタイム			
14:20				
15:00				

A会場(コンベンションセンター 3階 MOホール)	
15:10	MES2017表彰式
15:30	招待講演 1. AI及びGPUコンピューティングによる先進の自動運転プラットフォーム 馬路徹 氏(NVIDIA)
16:30	招待講演 2. シート型柔軟センサシステムの実装技術と次世代IoTへの展開 関谷毅 氏(大阪大学)
17:30	交流会
19:50	会場: ポプラ通り福利会館 2階 学生食堂

A会場: コンベンションセンター 3階 MOホール
 B会場: コンベンションセンター 2階 会議室2
 C会場: コンベンションセンター 2階 会議室3
 D会場: コンベンションセンター 1階 会議室1
 E会場: コンベンションセンター 1階 研修室
 ものづくり展示コーナー: コンベンションセンター 1階
 受付: コンベンションセンター 1階



	A会場	B会場	C会場	D会場	E会場	
9:00	<p>[2A1] ミッションフェローセッション 【第1部 特別講演】</p> <p>1. 創薬分野の研究開発について - 新薬創出と企業における創薬研究の構造 - ○安東治 氏(第一三共) (9:30~10:10)</p> <p>2. 機能的食品分野の研究開発について - ラクトフェリンの内臓脂肪低減効果の発見と機能的表示食品への応用 - ○村越倫明 氏(ライオン) (10:10~10:50)</p> <p>3. 消費財分野の研究開発について - 4800年の鏡の歴史への挑戦。toC向けIoTで重要なこと - ○遠藤国忠 氏(Novera) (10:50~11:30)</p> <p>【第2部 パネルディスカッション】 異分野から学ぶ 研究開発の将来像とは (11:35~12:10)</p>	<p>[2B1] 信頼性技術 -1 <評価・解析></p> <p>1. 窒化物パワーデバイスのパッケージングの最適化 ○内田智之, 杉江隆一(東レリサーチセンター)</p> <p>2. リザーバ構造配線におけるボイドとヒロクシの形成を考慮したエレクトロマイグレーション損傷の電流密度の評価 ○高谷隆司, 笹川和彦, 藤崎和弘, 森脇健司(弘前大学)</p> <p>3. パワーモジュールにおける樹脂-金属界面の熱サイクル疲労はく離強度の機械的疲労試験による予測 ○池田徹¹, 井上航太郎¹, 長尾元氣¹, 小金丸正明¹, 中井戸宙², 畑尾卓也²(¹鹿児島大学, ²住友ベークライト)</p> <p>4. エポキシ系アンダーフィルの疲労き裂進展におよぼすフィラー添加の影響 ○石橋淳¹, 菊谷義治¹, 佐藤敏行², 榎本利章³, 山口博²(¹芝浦工業大学, ²ナミックス)</p>	<p>[2C1] パワーエレクトロニクス -2 <界面技術></p> <p>1. Ag焼成膜付DBA基板への新規素子実装技術とその高温動作仕様における信頼性評価 ○西元修司, 新井浩也, 大橋東洋, 長友義幸(三菱マテリアル)</p> <p>2. 水素ラジカル処理した銅表面の初期再酸化挙動に関する研究 ○申盛斌¹, Eiji Higurashi^{1,2}, Michitaka Yamamoto¹, Tadatomo Suga¹(¹東京大学, ²National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST))</p> <p>3. 表面形状を変化させた電解Ni/Snめっき皮膜の摩擦摩耗特性 ○東翔也¹, 福田志生¹, 尾崎公一¹, 福田千紗², 西村宜幸², 水戸岡豊³(¹岡山県立大学, ²オーエム産業, ³岡山県工業技術センター)</p> <p>4. 静電噴霧を用いた絶縁薄膜による高耐熱展膜におよぼすフィラー添加の影響 ○岩井貴雅, 藪田良美, 藤野純司(三菱電機)</p>	<p>[2D1] 先端インターコネクト <接合・接続></p> <p>1. 導電性接着剤における界面構造形成と電気伝導特性発達挙動の解析 ○井上雅博, 根岸智仁(群馬大学)</p> <p>2. 高信頼性低温大気圧有機無機ハイブリッド接合 ○重藤暁津¹, 楊弘偉², 高振宏²(¹物質・材料研究機構, ²国立台湾大学)</p> <p>3. 異種金属を用いたナノポーラス構造による界面形成現象の比較 ○古賀俊一¹, 齋藤美紀子², 水野潤², 西川宏¹(¹大阪大学, ²早稲田大学)</p> <p>4. メモリデバイス向け高機能銀合金ボンディングワイヤ ○小山田哲哉¹, 宇野智裕¹, 山田隆², 小田大造²(¹新日鐵住金, ²日鉄住金マイクロメタル)</p>	<p>[2E1] 高周波技術 <接合・接続></p> <p>1. 波長1480nm直流光に対するInGaAs系HEMTの光変特性解析 ○高木一廣, 小境大輝, 中島駿, 田口博久(中京大学)</p> <p>2. マイクロ波によるセンサ給電技術 ○池田拓磨¹, 谷博之¹, 梶原正一¹, 田中勇気¹, 柳場亮祐¹, 佐藤浩¹, 小柳芳雄¹, 塚原法人¹, 那須博², 篠原真毅²(¹パナソニック, ²京都大学)</p> <p>3. 表面比導電率測定と電磁界シミュレーションを用いた配線基板導体損失の解析 ○福盛大雅¹, 赤星知幸¹, 水谷大輔¹, 山田哲郎²(¹富士通研究所, ²富士通アドバンスドテクノロジ)</p>	
10:20			<p>[2B2] 信頼性技術 -2 <検査・分析></p> <p>1. 実装基板内微小部における熱的・機械的的特性の評価 ○遠藤亮, 加藤敬, 野上晶代, 竹田正明(東レリサーチセンター)</p> <p>2. Sn-58Bi合金の機械的特性に及ぼすZn添加の影響 ○Shiqi Zhou, Omid Mokhtari, Hiroshi Nishikawa(Osaka University)</p> <p>3. IoTエッジプラットフォーム"トリリオンノード・エンジン"におけるゴムコネクタ接続構造の研究 ○阿川謙一¹, 森時彦², 二宮良次¹, 滝澤穂¹, 桜井貴康²(¹東芝デバイス&ストレージ, ²東京大学)</p> <p>4. プリント配線板の反りばらつきに対するビルドアップ用絶縁材料特性の影響 ○岡本圭司, 小原さゆり, 森裕幸(日本アイ・ピー・エム)</p> <p>5. 実装基板回路内抵抗断線のバンドリスキャンテストによる出荷後検出能力評価 ○神田道也, 数井大輔, 四柳浩之, 橋爪正樹(徳島大学)</p>	<p>[2C2] パワーエレクトロニクス -3 <Cuナノ接合/TLP></p> <p>1. 無加圧窒素雰囲気による銅ナノ粒子接合の信頼性 ○長谷川和基¹, 池田裕亮¹, 笠木靖文¹, 片桐克弥¹, 加藤裕和¹, 渡邊裕樹¹, 竹中彰宏¹, 山田靖¹, 佐野義之², 長田裕仁², 関根信博²(¹大同大学, ²DIC)</p> <p>2. 焼結金属接合の信頼性評価 ○組野哲也¹, 安藤拓司¹, 守田俊章², 安井感², 佐々木康二², 川瀬大助²(¹日立製作所, ²日立パワーデバイス)</p> <p>3. Cuナノ粒子/Bi-Sn合金ハイブリッド接合へのZn混合 ○佐藤敏一, 白井正則(豊田中央研究所)</p> <p>4. 銅-はんだ-樹脂複合材を用いた液相拡散焼結法によるパワーモジュール向けダイアタッチ技術 ○興裕章¹, Adrian Lis², 物種武士¹, 山口博¹, 加藤良裕², 廣瀬明夫²(¹三菱電機, ²大阪大学)</p>	<p>[2D2] 配線板・インターポーザ</p> <p>1. 湿式法によるTGV付きガラス基板への銅めっき ○高山昌敏, 井上浩徳, 代田洋輔, 若狭健人, 鬼武茂雄(江東電気)</p> <p>2. 銀ナノ粒子を下地とする銅パターン形成の検討 ○村川昭, 深澤憲正, 富士川亘, 白髪調(DIC)</p> <p>3. 微細シリコンTSVのSLBIC評価 ○崔雲, 末次正(福岡大学)</p> <p>4. i-THOP - 2.5Dタイプ有機インターポーザの開発 ○種子田浩志, 永井鑑治, 小山利徳(新光電気工業)</p> <p>5. 原子核実験のための長尺・高密度フレキシブル基板の開発 ○近藤崇¹, 峰谷崇², 中川裕², 柳川大輔², 佐藤如雪³, 藤原康平⁴(¹東京都立産業技術研究センター, ²理化学研究所, ³ハヤシレビック)</p>	<p>[2E2] プリントابل -1 <フレキシブル・ストレッチャブル></p> <p>1. 軸引張り負荷下での印刷有機薄膜トランジスタの電気特性評価 ○中城朋也¹, 小金丸正明¹, 穴戸信之², 関根智仁², 神谷庄司¹, 池田徹¹(¹鹿児島大学, ²北九州市環境エレクトロニクス研究所, ³山形大学, ⁴名古屋工業大学)</p> <p>2. ポリパラキレンの機械的特性と引張り負荷下での絶縁特性の評価 ○笹川宗太郎¹, 穴戸信之², 小金丸正明¹, 関根智仁², 神谷庄司¹, 池田徹¹(¹鹿児島大学, ²北九州市環境エレクトロニクス研究所, ³山形大学, ⁴名古屋工業大学)</p> <p>3. 種々の繰り返し引張条件におけるウレタン系ストレッチャブル配線の電気伝導特性変化の解析 ○井上雅博, 細野雄太(群馬大学)</p> <p>4. 連続波キセノン光焼成によるプラスチック基板に対する密着性の高い3次元インクジェット印刷配線の形成 ○吉田泰則, 和田輝, 泉小波, 時任静士(山形大学)</p> <p>5. 全方向インクジェット印刷技術による柔らかい立体物曲面上タッチセンサの直接形成 ○松村敬, 泉小波, 吉田泰則, 時任静士(山形大学)</p> <p>6. 全固体柔軟性引張スーパーキャパシタの作製 ○劉賢銘¹, 李万里², 李財富³, 福島大喜², 古賀大高², 長尾至成², 何剛³, 菅沼克昭²(¹Harbin Institute of Technology, ²大阪大学)</p>
12:10		ものづくりコアタイム				
12:40	ものづくりコアタイム					
13:30		<p>[2B3] 技術動向・インベージョン -1</p> <p>1. 開発テーマをどのように見つけますか? ○野上義生(東レエンジニアリング) (依頼講演40分)</p> <p>2. 近年の特許出願動向調査結果の紹介 - 実装分野に関連する調査を中心にして - ○小野行彦(特許庁) (依頼講演40分)</p>	<p>[2C3] パワーエレクトロニクス -4 <Agナノ接合></p> <p>1. 焼結した銀に対する金基板の熱処理の影響 ○張政, 陳天佑, 長尾至成, 菅沼克昭(大阪大学)</p> <p>2. 耐熱割裂を用いた低加圧銀ナノ粒子ペースト接合とせん断強度および引張強度 ○柏木行康¹, 齊藤大志¹, 長岡亨¹, 山田信司¹, 垣内宏之², 玉井聡行¹(¹大阪産業技術研究所, ²大研化学工業)</p> <p>3. Agナノ粒子の焼結接合における収縮挙動のその場測定 ○平塚大祐, 町野まゆみ, 山本哲也, 館山和樹(東芝)</p> <p>4. 新規銀ナノ粒子ペーストによるアルミニウムを中心とした接合技術の開発 ○長澤浩¹, 中島啓光², 雨宮隆², 伊藤公紀¹(¹環境レジリエンス, ²横浜国立大学, ³電気通信大学)</p>	<p>[2D3] センサ・MEMS -1</p> <p>1. IoT時代における、MEMSセンサの役割と要求事項への考察 ○河野好咲(オムロン) (依頼講演40分)</p> <p>2. 小型センサモジュール搭載シューズを用いた行動センシング ○島内岳明, 勝木隆史, 豊田治(富士通研究所)</p> <p>3. Si製アルカリ金属生成源を用いた小型原子時計用ガスセルプロセスの開発 ○木元雄一, 中村克生, 平井義和, 土屋智出, 田畑修(京都大学)</p>	<p>[2E3] プリントابل -2 <基板・評価></p> <p>1. エッチング工程を必要としない環境配慮型プリント配線基板製造工法の開発-5- ○加東隆¹, 北田真也², 本村研児², 鈴木治行², 山口範博³, 寺田恒彦³, 太田茂男³, 丸澤高⁴, 樋野遊一⁵, 加藤義尚⁶(¹奥野製薬工業, ²アサダメッシュ, ³タツタ電線, ⁴応化学工業, ⁵HINO実装設計, ⁶福岡大学)</p> <p>2. フィルム基板固定用真空吸着アシストシートの開発 ○齊藤拓也¹, 野口健吾¹, 宮口典子¹, 田中広志¹, 野村健一², 堀井美徳², 牛島洋史²(¹日本バイロン, ²産業技術総合研究所)</p> <p>3. Agナノインクを用いたSiウェハ上への電極形成:Ag/Siショットキー接合の評価 ○齊藤大志, 柏木行康, 玉井聡行(大阪産業技術研究所)</p> <p>4. 印刷銀電極のエレクトロケミカルマイグレーション解析と耐久性向上 ○関根智仁¹, 田村泰典, 熊木大介, 時任静士(山形大学)</p>	
14:50		<p>[2B4] 技術動向・インベージョン -2</p> <p>1 半導体製造装置 ○未定(日本半導体製造装置協会 (SEAJ)) (依頼講演40分)</p>	<p>[2C4] パワーエレクトロニクス -5 <Agナノ接合></p> <p>1. 銀フレークの焼結メカニズムに関する研究: 自己生成銀ナノ粒子 ○Jeyun Yeom, Li Cai-Fu, Nagao Shijo, Katsuki Suganuma(大阪大学)</p> <p>2. 複数の粒子径分布を持つマイクロ銀粒子による無加圧焼結での熱・電気伝導特性の向上 ○竹政哲, 立花芳恵, 酒金婷, 清野順子(千住金属工業)</p>	<p>[2D4] センサ・MEMS -2</p> <p>1. 自動追従システムにおける対象物認識率の向上 ○岡田英夫(富士通研究所)</p> <p>2. X線ドライエッチングを用いたPTFE微細加工 ○山口明啓, 竹内雅耶, 内海裕一(兵庫県立大学)</p> <p>3. 実用的なニードルタイプ・ナトリウムセンサに関する検討 ○松本圭司¹, 渡邊敬仁¹, 中村英司¹, Ruch Patrick², Zafar Sufi²(¹日本アイ・ピー・エム, ²IBM Research-Zurich, ³IBM Research-Yorktown)</p>	<p>[2E4] プリントابل -3 <印刷プロセス></p> <p>1. ソフトブランクケトグラビア (SBG) 印刷による異種基板配線の新規相互接続技術および曲面上の回路への応用 ○泉小波, 中村裕之, 吉田泰則, 時任静士(山形大学)</p> <p>2. ソフトブランクケトリバースオフセット (SBR) 印刷に適した絶縁材料インクの開発および曲面上への応用 ○齋藤光, 吉田泰則, 泉小波, 時任静士(山形大学)</p> <p>3. 銅ナノインクを用いた低耐熱基材上での導電パターン形成 ○宮本一誠, 有村英俊(石原ケミカル)</p>	
15:00						
16:00						